

Subgingival Kazıma ve Kök Planlama Nedir?

Çalışma Kağıdı

Subgingival kazıma, diş eti cebinin içindeki kök yüzeylerinden enfekte dokuların ve diş taşlarının kürete edilmesi; kök planlama ise bu yüzeylerin pürüzsüzleştirilerek yeniden plak birikimini zorlaştırmasıdır.

Sorular

1. Subgingival kazıma ve kök planlama işleminin ana hedefi nedir?
 - A) Diş beyazlatma
 - B) Periodontal ceplerdeki plak ve diş taşlarını temizlemek
 - C) Ortodontik tedavi uygulamak
 - D) Diş minesini güçlendirmek
2. Kök planlama, kazıma işleminden sonra neden yapılır?
 - A) Daha fazla diş taşı birikmesini sağlamak için
 - B) Diş etlerinin daha hızlı çekilmesi için
 - C) Kök yüzeylerini pürüzsüzleştirerek bakteri tutunmasını azaltmak için
 - D) Dişlere daha estetik bir görünüm kazandırmak için
3. Aşağıdakilerden hangisi subgingival kazıma ve kök planlama için kullanılan bir araç değildir?
 - A) Küret
 - B) Kavitron
 - C) Diş fırçası
 - D) Ultrasonik scaler
4. Subgingival Kazıma ve Kök Planlama Hangi Durumlarda Uygulanır?
5. İşlem Sırasında Hangi Araçlar Kullanılır?
6. Tanımla: Subgingival Kazıma Nedir?
7. Tanımla: Kök Planlama Nedir?
8. Tanımla: Hangi Araçlar Kullanılır?

Cevap Anahtarı

1. B) Periodontal ceplerdeki plak ve diş taşlarını temizlemek — Bu işlem, diş eti altındaki enfekte yüzeyleri temizleyerek periodontal sağlığı iyileştirmeyi amaçlar.
2. C) Kök yüzeylerini pürüzsüzleştirerek bakteri tutunmasını azaltmak için — Pürüzsüz kök yüzeyleri, bakterilerin tutunmasını zorlaştırır ve iyileşme sürecini destekler.
3. C) Diş fırçası — Diş fırçası, ağız hijyeninin bir parçasıdır ancak subgingival kazıma ve kök planlama gibi profesyonel periodontal tedavi araçları arasında yer almaz.
4. Periodontal hastalıkların (gingivitis, periodontitis) erken ve orta evrelerinde, diş eti cebi derinliği arttığında, diş eti kanaması ve iltihabı görüldüğünde, diş eti çekilmesi ve dişlerde sallanma başladığında subgingival kazıma ve kök planlama gereklidir.
5. Bu işlemde genellikle el aletleri (küretler, kavitron gibi ultrasonik cihazlar) kullanılır. Küretler, diş eti cebine girerek diş taşlarını ve plağı kazımak için tasarlanmış özel uçlara sahiptir. Ultrasonik cihazlar ise yüksek frekanslı titreşimlerle diş taşlarını kırmak ve uzaklaştırmak için kullanılır.
6. Diş eti çizgisinin altındaki kök yüzeylerinden plak ve diş taşlarının kazınmasıdır.
7. Kazıma sonrası kök yüzeylerini pürüzsüzleştirerek yeniden plak yapışmasını engelleme işlemidir.
8. Küretler ve ultrasonik cihazlar (kavitron).

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.